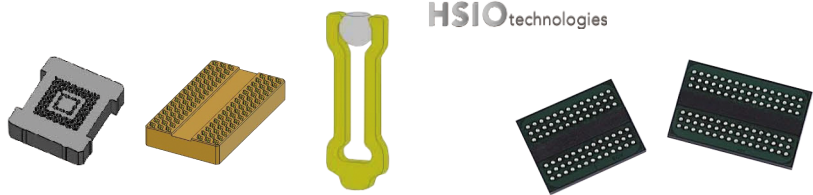


Grypper Contact Matrix

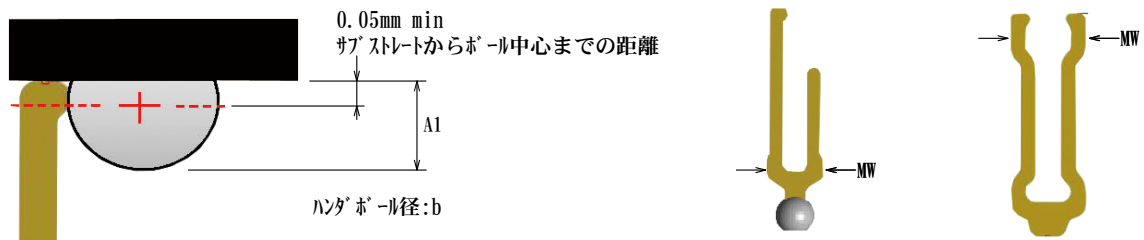
グリップーコンタクト分類表




- BGAデバイス用 ●デバースイズ
- フタなし ●S21特性>40GHz



グリップーソケットに適合するためのハンダボール寸法仕様

HSIO社 グリップーのコンタクトに適合する最少ハンダボール寸法を示します。グリップー技術は、デバイスのハンダボールの露出高さが最少以上であり、ハンダボールの中心位置が明確であると、ソケットによるハンダボールの"Gripping (グリップング)"を確実に行えます。



グリップーの種類	ハンダボール径* +0.0mm -0.05mm (b)	最少ボール 露出高さ A1 =1/2b±0.05	最少ピッチ	最大コンタクト巾 (MW)	最少ボール間 対角寸法 (MW)	HSIO社 コンタクト品番
G35 Grypper	G35コンタクトは、ピッチ0.35mmに使用され、HSIO銅ピラー付のハンダポンプタイプです。					
	0.20	0.130	0.35	0.355		104468-0028
	0.20	**	0.35	0.355		104468-0029
	**コンタクトは HSIO interposer Coupons (開発中) に適合します。 0.35mmピッチデバイスはボールの中心がなく、ハンダポンプ形状です。					
G40 Grypper	標準G40コンタクトは、ピッチ0.4mmと0.5mmに使用されます。					
	0.25	0.175	0.40	0.425		104468-0014
	0.30	0.200	0.50	0.500		104468-0015
	0.35	0.225	0.50	0.500		104468-0025
	0.45	0.275	0.575	0.575		104468-0050
G80 Grypper	標準G80コンタクトは、300個以下のボール数 (0.65mmピッチから1.0mmピッチ) のときに使用されます。					
	0.40	0.250	0.65	0.640		104468-0024
	0.45	0.275	0.65	0.650		104468-0026
	0.45	0.275	0.80	0.750		104468-0016
	0.50	0.300	0.80	0.750		104468-0006
	0.55	0.325	0.80	0.775		104468-0017
	0.60	0.350	1.00	0.800		104468-0009
	0.65	0.375	1.00	0.825		104468-0018
G80 LIF Grypper	G80 LIFコンタクト (低挿入力タイプ) は、300個以上のボール数のときに使用されます。					
	0.35	0.225	0.65	0.640		104468-0053
	0.40	0.250	0.65	0.650		104468-0046
	0.45	0.275	0.80	0.750		104468-0043
	0.50	0.300	0.80	0.775		104468-0044
	0.55	0.325	0.80	0.800		104468-0052
	0.60	0.350	1.00	0.825		104468-0042

*適性なソケット接触を得るためには、実際のボール寸法を、事前に測定する必要があります。A1寸法をボール径の公称値から計算したとき、A1は、0.05mm以下でも可能な場合があります。上記ガイドラインに当てはまらない場合は、HSIOに一応、ご相談ください。

標準グリップーとG80はコンタクトにハンダボールは付いていません。(ハンダボール付はオプションになります)

実装には、別売のスタンを使用してください。

G35とG40はコンタクトにハンダボール付きです。リフロー条件は、BGAデバイス直接のときとほぼ同じです。スタンを使用しません。

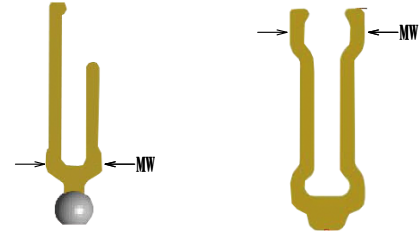
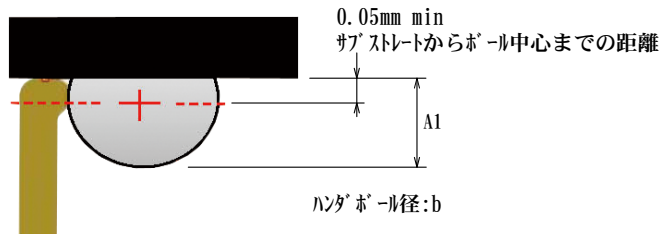
ハンダボールなしはオプションになります。

Grypper Contact Matrix

HSIO technologies

グリッパ-コンタクト分類表

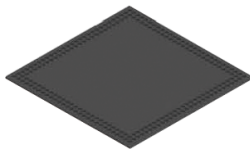
グリッパ-ケットに適合するためのハンダボール寸法仕様



グリッパ-の種類	ハンダボール径* +0.0mm -0.05mm (b)	最少ボール 露出高さ A1 =1/2b±0.05	最少ピッチ	最大コンタクト巾 (MW)	最少ボール間 対角寸法 (MW)	HSIO社 コンタクト品番
G80 LIF Grypper	G80 LIFコンタクト (低挿入力タイプ) は、300個以上のボール数のときに使用されます。					
	0.35	0.200	0.65	0.640		104799-0001
	0.35	0.225	0.65	0.650		104799-0003
	0.40	0.250	0.65	0.650		104799-0002
	0.45	0.275	0.80	0.750		104468-0002
	0.50	0.300	0.80	0.750		104468-0001
	0.60	0.350	1.00	0.850		104653-0001
	0.65	0.375	1.00	0.900		104653-0003

*適性なソケット接触を得るためには、実際のボール寸法を、事前に測定する必要があります。A1寸法をボール径の公称値から計算したとき、A1は、0.05mm以下でも可能な場合があります。上記ガイドラインに当てはまらない場合は、HSIOに一応、ご相談ください。

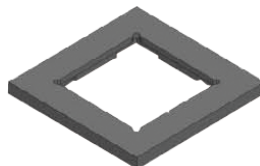
ステンシル
グリッパ-とG80用
ソケットに必要です (別途ご注文)



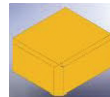
オプション製品
グリッパ-とG80に
ハンダボール付



G35とG40はコンタクトにハンダボール付きです。リフロー条件は、BGAデパイク直接のときとほぼ同じです。ステンシルは使用しません。ハンダボールなしはオプションになります。アライメントフレームは、G35とG40ソケットとICパッケージの、はめ込みのための位置だしをするのに使います。



デパイクプレス (オプション) は、デパイク上面に一定の力を加えるのに使います。



日本コネクト工業株式会社
JC ELECTRONICS CORPORATION